



TE 内部编号 1759513-1

Board-to-Board, 52 Position, .8 mm [.031 in] Centerline, 9 mm [.354 in] Stack Height, Gold Flash, Tape & Reel, Mini PCI Express & mSATA

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > Mini PCI Express 和 mSATA



总线类型: Mini PCI Express

连接器系统: 板对板

位数: 52

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

堆叠高度: 9 mm [.354 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	52
----	----

接触件特性

端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	镀金
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子额定电流（最大值）	.5 A

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
---------	----------------

尺寸

堆叠高度	9 mm[.354 in]
------	---------------

使用环境



工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

总线类型	Mini PCI Express
------	------------------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

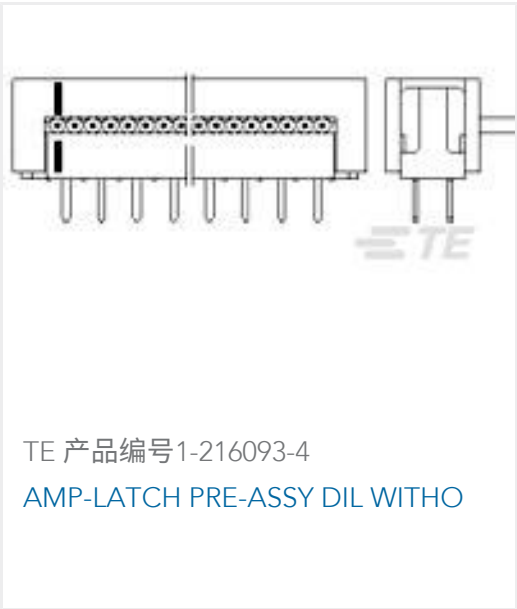
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

0.8MM MINI PCI EXPRESS CONNECTOR 9H

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1759513-1_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_1759513-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1759513-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[8-1773459-7_EXPRESS_MINI_CARD_AND_DISPLAY_MINI_CARD_SOCKETS_QRG](#)

英文版本

产品规格

英文版本